

技术参数

5305



应用介绍

特点

一款单组份环氧树脂胶，加热固化，流平好等特点，具有较高耐候性及稳定可靠性能；适用于PCB和电子芯片之间的粘接。

粘接材料

金属，陶瓷，塑料/PCB，玻璃等

典型应用

PCB 和电子芯片之间的粘接

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂	
颜色	银色	
粘度(cps)	18000	5rpm@25℃, ASTM D-1084
固化条件*	60mins@80℃	
比重	4.4g/cm ³	
有效期@ -20℃,月	6	

*固化温度是指实际到达胶水表面温度

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	银色	
电阻率	3.0*10 ⁻³ Ω.cm	
硬度	94D	ASTM D-2240
TG	98℃	DSC TA Q20, 40℃/MIN
CTE	α 1=29.5ppm/℃ (< Tg) α 2=188.8ppm/℃ (> Tg)	
粘接强度	10.2MPa	金+玻璃

可靠性	数值	测试方法
工作温度范围*	-55℃—180℃	

储存和使用方法

产品需低于-20℃环境中保存，使用前请先移至室温解冻，5ml 包装至少回温 2 小时。使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件。

注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户

www.stick1mat.com

Email: info@stick1mat.com

上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号



技术参数 5305



日期：01/2026

上海禧合应用材料

正式使用前请做好各种测试工作。

www.stick1mat.com

Email: info@stick1mat.com

上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号

